

科技发展 | 2024年电子设备展会及制造设备展会、电子芯片材料展

产品名称	科技发展 2024年电子设备展会及制造设备展会、电子芯片材料展
公司名称	中国（耀瀚）展会信息
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	17810353883 17810353883

产品详情

SEMI-e2024第六届深圳国际半导体技术暨应用展览会

展览时间：2024年06月26-28日 展览地点：深圳市国际会展中心（宝安新馆）

随着5G、人工智能等技术的快速发展，电子芯片行业将迎来更加广阔的市场前景。本次展会将为国内外企业提供一个展示和产品的平台，促进技术交流和合作，推动电子芯片行业的快速发展。同时，展会也将为观众带来一场精彩的技术盛宴，让大家深入了解电子芯片行业的发展趋势和应用前景。

SEMI-e2024第六届深圳国际半导体技术暨应用展览会，作为半导体行业的一次盛会，吸引了全球众多企业和人士的关注。本次展览会不仅展示了新的半导体技术和产品，更深入地探讨了半导体行业未来的发展趋势和机遇。

在展览会现场，各种高科技产品琳琅满目，其中不乏引领行业潮流的创新产品。这些产品不仅展示了半导体技术的新成果，也反映了半导体行业在技术创新和产业升级方面的努力。同时，现场还有众多和学者进行了深入交流和探讨，为半导体行业的未来发展提供了宝贵的建议和思路。

展示范围1、设计、芯片、晶圆制造与封装：集成电路设计及芯片、晶圆制造、SiP先进封装、功率器件封测、MEMS封测、硅晶圆及IC封装载板、封装基板与应用制造与封测、EDA、MCU、封装基板半导体材料与设备及零部件等

2、先进材料：硅片及硅基材料、光掩模板、电子气体、光刻胶及其配套试剂、CMP抛光材料、靶材、封装基板、引线框架、键合丝、陶瓷基板、芯片粘合材料等

3、IC载板/陶瓷基板：IC载板及封装工艺(基板、铜等结构材料及干膜、金盐等化学品/耗材) Chiplet封装技术、存储、MEMS及芯片应用及材料、设备。陶瓷基板与封装材料及设备等

- 4、半导体显示/Mini/Micro-LED：OLED、AMOLED、Mini/Micro LED显示、柔性显示与材料及设备等
- 5、半导体专用设备&零部件：减薄机、单品炉、研磨机、热处理设备、光刻机、刻蚀机、离子注入设备、CVD/PVD设备、清洗设备切割机、装片机、键合机、测试机、分选机、探针台及零部件等
- 6、第三代半导体：氮化(GaN)和碳化硅(SiC)、氧化锌(ZnO)、金刚石、晶圆、衬底与外延、功率器件、IGBT封装材料、射频器件及加工设备等
- 7、元器件：无源器件、半导体分立器件/IGBT、5G核心元器件特种电子、元器件。电源管理、传感器、存储器、连接器继电器、线缆、接插器件、晶振、电阻、显示器件、二极管、三极管滤波元件、开关及元器件材料及设备等
- 8、机器视觉与传感器：各类感知元件、执行器、智能传感器、工业传感器、传感器芯片、传感器生产与制造设备、配件等
- 9、电源&储能技术：储能电源及传感器、电池管理芯片、功率半导体器件及材料和相关设备、仪器及零部件等
- 10、毫米波雷达/激光雷达/自动驾驶：毫米波雷达模组、射频芯片、天线及高频PCB、高频材料、生产组装设备等汽车雷达传感器上下游供应链各环节产品等
- 11、微电子综合智造区：电子自动化、机器自动化、视觉检测、环保、清洗设备、检测设备、测试仪器、配件等
- 12、AI与算力、算法、存储、CPO共封装：人工智能芯片、方案、算力芯片及方案、算法方案数据存储、光电共封装模块及技术和设备等
- 13、汽车半导体/车规级先进封装技术：车规级半导体主控/计算类芯片、功率半导体(IGBT和MOSFET)、车规级SiC模块、电源管理芯片、汽车电子微组装及功率器件、封装测试设备、自动化设备、国际半导体材料商、设备商、封测、制造、代工厂商等

在展览会上，我们不难发现，半导体行业正面临着前所未有的机遇和挑战。一方面，随着5G、物联网、人工智能等技术的快速发展，半导体行业的需求呈现出爆发式增长。另一方面，半导体技术的复杂性和成本也在不断增加，给行业发展带来了不小的压力。因此，如何在机遇和挑战中寻求平衡，成为半导体行业亟待解决的问题。

针对这些问题，本次展览会也提供了一些解决方案。首先，展览会加强了产业链上下游企业之间的交流和合作，促进了产业链的协同发展。其次，展览会还推动了半导体行业与其他领域的融合，开拓了新的应用领域和市场。后，展览会还注重人才培养和技术创新，为半导体行业的未来发展提供了有力的人才和技术保障。